

PX-415 die-attach芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂

产品名称	PX-415 die-attach芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂
公司名称	上海锐驰创通电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PX-415 品牌:Polymeric 粘合材料类型:电子元件、金属类
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 漕宝路103号自动化仪表城1号楼1301室
联系电话	86-021-64832039 13611807922

产品详情

型号 PX-415 品牌 Polymeric
粘合材料类型 电子元件、金属类

px-415die-attach芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂

die-attach adhesive

耐高温芯片粘接粘合剂

polymeric px-415

耐高温

高导热

丝网印刷和无需丝网印刷

说明

polymeric px-415是一种双马来酰亚胺树脂基芯片粘接粘合剂。它适用于在fr4或al2o3衬底上粘接硅芯片，并提供高导热性和耐高温性。 px-415使分配达到最优化。

产品数据

颜色 黄

粘度 (23) 中等 (丝网印刷和无需丝网印刷)

保质期 (2-35) 12个月

b阶固化 125 30分钟

烘烤 130 20分钟+175 60分钟

后焙烘 200 1小时 (可选)

工艺

丝网印刷

该糊状粘合剂应用于结构化的丝网，然后将其转移印到基板上。粘合剂层厚应不超过400 μm 。当粘合剂转印到基板后，再进行b阶固化。

b阶固化

在125 30分钟固化 (粘合剂层厚 $<400\ \mu\text{m}$)

装配条件

芯片尺寸：8mm \times 8mm

基板温度：50

芯片温度：50

装配力：15 n

用层厚为250 μm b价粘合剂，将芯片陷入胶70-100 μm 。释放装配力后，芯片将弹回18-24 μm 。

固化

1. 15分钟加热到130 $^{\circ}\text{C}$
2. 20分钟恒温在130 $^{\circ}\text{C}$
3. 15分钟加热到175 $^{\circ}\text{C}$
4. 60分钟恒温在175 $^{\circ}\text{C}$
5. 60分钟降温至30 $^{\circ}\text{C}$

清洗设备

粘合剂的痕迹可以用丙酮去除。数量较大时，使用n-甲基吡咯烷酮， - 丁内酯或亚甲基氯化物来溶解。当使用这些溶剂时，请遵守安全规定。避免接触皮肤和眼睛。

固化产品的典型特性

特性	方法	数值
分解温度	热重分析 (tga) 10k/min , 5%的重量损失	390
热膨胀	动态热机械分析/热机械分析(dma/tma) 2k/min 0.05n , 25-200	ca. 42ppm/k
玻璃化温度 tg	动态热机械分析(dma) 薄膜张力2 k/min, 1 hz	
	175 1小时 固化后	133
	175 1小时 + 225 1小时固化后	172
储能模量e	动态热机械分析(dma) 薄膜张力2 k/min, 1 hz	
	175 1小时 固化后	4400mpa@25
热点率		1.5w/mk
击穿电压ed		3kv/mm
硬度	shore d	50

贮藏

在5-8 ，粘合剂在其原始的包装中保存。避免阳光的直射。存储期限为出厂日后12月之内。

废弃物处置

未使用的粘合剂必须固化后再按照当地的法规进行处理。

安全措施

当使用粘合剂时，请佩戴安全眼镜和手套。更多信息请参阅msds.

产品链接：http://www.acctrionics.com/productid/product_detail-10498002.html

服务网址：www.acctrionics.com

服务电话：400-600-3652

锐驰创通电子科技有限公司努力为您提供优质服务